



主力製品 半導体材料切断装置

- 本社所在地：大阪府摂津市
- 事業概要：加工装置および工具の開発・製造・加工・販売
- 1) 半導体、FPD、太陽電池、電子部品などの分断やパターニング等
- 2) レーザーエンジン、スクライビングホイール、高硬度難削材等
- 常時使用する従業員：204名（2024年12月時点）
- 現在の売上高：33億円（2024年12月期）
- 法人番号：3120901009447
- Web：
<https://www.mitsuboshidiamond.com>

三星ダイヤモンド工業株式会社（製造業）

企業理念・100億宣言に向けた経営者メッセージ



代表取締役社長
若林 真幸

脆性材加工技術で未来社会を創る

脆性材の精密加工というニッチ市場に特化し、革新的なAIやDX技術を積極的に取り入れ「匠の技」と「最新のテクノロジー」を融合させた、お客さまの安定した生産活動を支えるソリューションを提供します。次々に生み出される新材料に対しても、大学や材料メーカーなどの研究開発機関と強固な連携を築き、いち早く加工技術を確立。業界のリーダーとして、常に最前線に立ち続けます。三星ダイヤモンド工業は、生活・モビリティ・インダストリー・エネルギーインフラの未来を、切る技術で支え、未来社会の実現に貢献します。

売上高100億円実現の目標と課題

実現目標

2033年の売上高100億円達成に向け、ディスプレイ・ガラス分断市場での市場浸透、半導体・太陽電池市場等新市場開拓、高硬度工具・ダイヤモンド成膜の多角化推進、事業化を目指す



課題

- ・主要メーカー／ターゲット市場での認知／実績拡大
- ・地域、現地での生産／保守パートナー増強
- ・生産状況監視／自動化／自律化機能開発
- ・多種多様な消耗品の生産効率化／品質管理体制強化
- ・培った分断ノウハウのナレッジ化
- ・データドリブンで意思決定できる人材の育成／業務改革

売上高100億円実現に向けた具体的措置

目指す成長手段

- 【市場浸透】
- ・顧客接点強化
 - ・IT技術活用でのニーズ収集、対応強化
- 【新市場開拓】
- ・継続的優位性を持つ新工具・工法開発
 - ・多品種小ロット効率生産の実現
- 【多角化】
- ・硬脆材の微細加工を実現するレーザーエンジン開発

実施体制

- 【市場浸透】
- ・販売代理店開拓、ニーズ収集方法確立、ノウハウ共有
 - ・社長直轄での企業-事業戦略統合とIT導入／推進強化
- 【新市場開拓】
- ・マトリックス型組織と階層別研修強化による、専門性強化と事業推進の両利き経営実現
- 【多角化】
- ・国内パートナー協業、産官学連携によるコア技術深化

※本宣言は企業自身がその責任において売上高100億円を目指して、自社の取組を進める旨を宣言するものです